데이터 시트

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

모듈방식 CH20M 하우징의 기본 요소는 여러 가지 장점을 제공하여 프로젝트에 탁월한 선택입니다. 버스 및 FE 연락처를 위한 특수 컷아웃이 있어 특히 유연하고 적응력이 뛰어납니다.
또 다른 장점은 하우징에 레이저 인쇄 옵션이 있어 높은 정밀도와 개별 디자인 옵션을 제공한다는 것입니다. 다양한 색상도 사용 가능하여 원하는 대로 하우징을 디자인할 수 있습니다.
CH20M 하우징은 표준 조립 레일에 적합하기 때문에 기존 시스템에 설치하고 통합하는 것이 더 쉽습니다.

일반 주문 데이터

버전	조립 레일 하우징, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 검정, 측면 요소, 연결 준비 마이크로 SIM 카드 (3FF), 너비: 45 mm
주문 번호	2738670000
유형	CH20M45 B SIM BK/BK 2010
GTIN (EAN)	4064675064091
수량	6 items

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	108 mm	깊이 (인치)	4.252 inch
높이	109.3 mm	높이 (인치)	4.3031 inch
너비	45 mm	폭 (인치)	1.7716 inch
순중량	36.53 g		

온도

주변 온도	-25 °C...85 °C	작동 온도 범위	-40...120 °C
습도	5 - 93 % 상대 습도, Tu = 40°C, 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66 GF 30
절연재 그룹	I	표면 마감	미처리
기본 재질	플라스틱	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI

일반 데이터

컬러 코드	검정	보호 등급	IP20(설치 상태)
장착 레일	TS 35	컬러 차트(유사)	RAL 9011
캡슐화 옵션	아니요		

조립품 속성

장착 어셈블리 암형 커넥터용 슬롯 수, 최대	12	PCB 개수, 최대	2
결선 수준 수, 최대	3	극 수, 최대	48
PCB의 구성 요소 높이(1개의 PCB 사용), 최대.	38.6 mm	PCB의 구성 요소 높이(2개의 PCB 사용), 최대.	34.7 mm
PCB 어셈블리 유형	양면		

기계적 테스트

표준 부합	DIN EN 61373:1999 (충격 및 진동)	
시험 조건	하우징 5개 연속 설치, PCB당 추가 중량 200g, PCB 2개 탑재	
입증된 액슬	X, Y, Z	
충격 시험	일반 시험 지침	모든 기계적 시험은 예시 설정 또는 관련 규정 관점에서 실시했습니다. 명시된 결과가 승인 관련 테스트를 대체하지는 않습니다. 단순히 지향값에 불과합니다.
	시험 카테고리	1
	액슬당 충격 수	양극 및 음극 방향 3개
	충격 지속 시간	30 ms
	가속 가로	30.00 m/s²
	가속 수직	30.00 m/s²

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	가속 세로	50.00 m/s²
진동 시험	시험 카테고리	1B
	시험 지속 시간	액슬당 5시간
	효과적인 가속	7.9 m/s²

열 테스트

열 시험	일반 시험 지침	모든 열 시험은 예시 설정 또는 관련 규정 관점에서 실시했습니다. 명시된 결과가 승인 관련 테스트를 대체하지는 않습니다. 단순히 지향값에 불과합니다.
	시험 조건	하우징 7개 연속 설치 - 간격 없음
	시험 액슬	수평
	주변 온도	55 °C
	전력 방출, 최대	4.2 W
	주변 온도	50 °C
	전력 방출, 최대	4.8 W
	주변 온도	40 °C
	전력 방출, 최대	5.9 W
	주변 온도	20 °C
	전력 방출, 최대	8.25 W

부품 속성

클립온풋 색상	검정	다음에 대한 대비로서 클립온풋 부분의 컷아웃	마이크로 SIM 카드(3FF)
결선 수준 수, 최대	3		

디자인 - IN 요구 사항

PCB 형태에 대한 공차	±0.1 mm	PCB 두께	1.6 mm
회로 보드 두께의 공차	±0.15 mm		

개별화 옵션

고객 맞춤 라벨 표시 가능	예	고객 특정적 주문 절차	다운로드 아래 지침 참조
대체 색상	요청 시 추가	처리 가능성	레이저 가공

중요 참고 사항

제품 정보	회로기판 윤곽, 제한 구역 및 그 외 회로기판 설계 관련 정보는 다운로드 섹션의 해당 수형 헤더 아래의 결선 기술 카테고리에서 확인하실 수 있습니다.

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

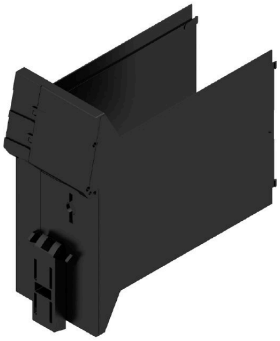
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

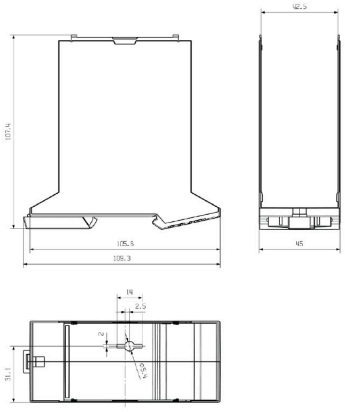
www.weidmueller.com

도면

제품 이미지

제품 장점



Basiselement einschließlich SIM-Ausschnitt

치수 도면